

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 9 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	9 月 3 日 盛博证券、南丰集团三合投资、信安资产管理、普信投资、柏駿資本管理、德意志资产管理、高盛(亚洲)、安联环球投资、新加坡安达投资、博裕资本、守正基金管理(香港)、威灵顿管理公司、柏駿資本管理(香港)、方瀛研究与投资、Carmignac Gestion、CBUS Super、Arena Holding Management LLC、Redwheel、Coatue Management LLC 9 月 4 日 东方证券、东北证券、申万宏源证券、国新投资、朴拙资本、上海汉鸿私募、茁安投资、中航信托、长江证券(上海)资产管理、歌斐资产、永安财产保险、上海益昶资产管理、卓跃产业投资、中信资管、国金证券自营、华西证券、高毅资产、璞远资产、上海朱雀资产管理、鸿漪私募基金、龙航资管、华创证券、西南证券自营投资部、新华基金、兴合基金、野村东方国际证券、浦银安盛基金、相聚资本、才华资本、路博迈基金、兴银理财、诺德基金、淳厚基金、华泰保兴基金、光大证券资

	管 9月15日 人保资产、交银施罗德基金、中银基金、融通基金 9月26日 Barclays、浦银国际
时间	9月3日、9月4日、9月15日、9月26日
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司如何把握国产替代机遇，推动自身快速发展？ 答：公司围绕国内市场需求，推进高端化、定制化产品开发，助力客户提升产品竞争力，在本土产业链中形成“深度绑定”优势，与核心客户构建深度协同、相互赋能的战略合作关系，打造价值共同体。 同时，公司持续优化产品与市场结构，不断提升在汽车电子、新能源、工业控制等领域的业务占比，目前上述领域在公司自有产品中的营收贡献已超过60%，成为公司增长的核心驱动力。伴随AI技术推动下游产业升级与市场扩容，公司积极布局数据中心、人形机器人、智能驾驶、低空经济等新兴领域，相关产品已实现规模化上量，持续拓宽国产替代的应用场景与技术边界，为公司长远发展打开更广阔的空间。 问题二：请问公司如何判断下游的长期增长需求？ 答：公司当前订单能见度保持在2-3个月，整体需求呈现向好的态势。具体来看：汽车电子作为公司核心增长点，受益于今年新项目的导入及汽车电动化、智能化产业趋势，预期仍将实

现进一步增长；消费电子领域，特别是白电，在三季度末进入传统旺季，需求逐步回暖；新能源及工控领域整体需求保持平稳；AI 相关领域，如算力服务器、人形机器人等新兴应用正逐步打开新的增长空间。

问题三：公司围绕人工智能有哪些产品布局？

答：公司积极推进人工智能领域的产品与业务布局，重点聚焦汽车电子、数据中心、机器人等高增长应用场景，在电机驱动、电源管理、电池管理、智能控制及传感器等产品方向实现规模上量及研发布局，为客户提供高度适配的系统级产品解决方案。

问题四：请问公司在 AI 服务器电源领域的最新进展？

答：在 AI 服务器电源领域，公司目前已实现 SGT MOS、SJ MOS、SiC MOS 和 GaN 产品的批量供应。此外，超百颗包括中低压、高压、特种器件及第三代半导体等适用于服务器领域的新产品正处于研发阶段，公司在 AI 领域的增长空间与增速有望进一步扩大。

问题五：请问公司各产线的产能利用率情况？

答：晶圆制造方面，公司 6 吋、8 吋、重庆 12 吋产线基本都处于满产状态，深圳 12 吋产线稳步爬坡中；封装测试方面，产能利用率保持在 85%以上，好于去年同期水平。

问题六：请问公司第三代半导体的业务发展，如何展望未来的发展趋势？

答：公司碳化硅产品，围绕汽车电子、充电桩、光伏储能、数据中心电源等全面推广上量。研发方面，新产品 SiC JBS G3 和 SiC MOS G2 均已完成产品系列化并量产，整体产品性能达到

	国际领先水平；公司已同步开发 SiC MOS G3、G4 平台，并启动平台系列化工作，以应对高效率应用场景的需求。 公司氮化镓产品，已实现全电压覆盖，主要面向消费电子、汽车电子、通讯设施、数据中心四大领域。目前，公司在网通、全球 TV 和显示屏市场已成为氮化镓头部供应商。研发方面，中高压平台多颗产品开发制版中，高压平台产品有望在今年年底投片；E-MODE 平台建设及产品研发取得突破性进展，代表产品可靠性通过 1000 小时考核。 整体来看，公司碳化硅与氮化镓产品均保持了产销规模的高增长，我们看好其未来市场空间与增速的持续放大。 问题七：请问公司投资并购的方向？ 答：投资并购是公司的重要战略方向，我们重点关注功率半导体、智能传感器及智能控制等方向，标的需具备一定的营收规模或在其细分领域拥有领先的技术或市场地位。公司希望通过投资并购实现技术互补、客户共享、产能协同，进一步巩固和提升产业链整体竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月